

ダイシング加工 試作から量産までのサンテック

地球環境を配慮した企業活動を推進しています。



超薄く
削る BG加工

微細に
切る ダイシング加工

正確に
詰める チップソート

厳しく
見る 外観検査

ダイシング加工

光学ガラス

面取り加工 (8角形)

光学ガラス面取り加工 (両面)

シリコンガラス

BG加工

シリコンウェハの超薄型研削

研削後のダメージを軽減

チップソート

光学ガラス

微細チップ

ウエハ研削及び特殊素材
(ガラス、セラミック、ガラエポ基板など)の
加工についても対応可能です。
ご相談ください。

SUNTEC 株式会社 サンテック

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-1-10
TEL 042-557-7744 (代) FAX 042-557-7745
E-mail : suntec@c-suntec.co.jp
URL : <http://www.c-suntec.co.jp>



ISO 9001 ISO 14001